# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-265088

(43) Date of publication of application: 11.10.1996

(51)Int.CI.

H03H 9/145 **H03H** 3/08

H03H H03H

(21)Application number : 07-064396

(71)Applicant : MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

23.03.1995

(72)Inventor: SHIMOE KAZUNOBU

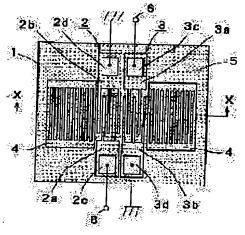
HIRAISHI AKIRA

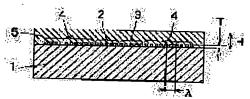
# (54) SURFACE ACOUSTIC WAVE RESONATOR FILTER

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the inexpensive and small sized surface acoustic wave resonator filter with excellent temperature characteristic, high performance and broad band.

CONSTITUTION: Interdigital transducers(IDTs) 2, 3 are formed close to each other on a 36° Y-cut X propagation LiTaO3 piezoelectric substrate 1, reflectors 4, 4 are formed to the outside of the IDTs 2, 3, and an SiO2 film 5 is formed to cover the IDTs 2, 3 and the reflectors 4, 4. The IDTs 2,3 and the reflectors 4, 4 are made of an Al, or Al, alloy and the electrode film thickness of the IDTs 2, 3, and the reflectors 4, 4, the film thickness of the SiO2 film 5, and the total electrode finger pair number of the IDTs 2, 3 are selected to be a specific number.





### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

19.02.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3407459

[Date of registration]

14.03.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-265088

(43)公開日 平成8年(1996)10月11日

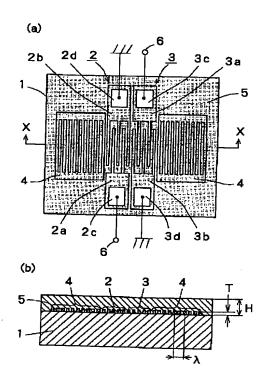
審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全7頁) (21)出願番号 特願平7-64396 (71)出願人 000006231 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 (72)発明者 下江 一伸 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内 (72)発明者 平石 明 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内	(51) Int. C1. <sup>6</sup> H O 3 H	9/145 3/08 9/25 9/64	識別記号	庁内整理番 7259 — 5 J 7259 — 5 J 7259 — 5 J 7259 — 5 J	号	F I H O 3 H	9/145 3/08 9/25 9/64	C C z	技術表示管	所
(22) 出願日 平成7年(1995) 3月 23日 株式会社村田製作所 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 (72) 発明者 下江 一伸 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内 (72) 発明者 平石 明 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式会社村田製作所内		審査請求	未請求請求	項の数 5	OL			(全7頁)		
(72)発明者 下江 一伸 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式 会社村田製作所内 (72)発明者 平石 明 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式						(71)出願人	株式会社村田製作所			
京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式						(72)発明者	下江 一伸 京都府長岡京市天神二丁目26番10号 株式			
							京都府長岡		26番10号 株	試

# (54)【発明の名称】表面波共振子フィルタ

## (57)【要約】

【目的】安価かつ小形で、温度特性の良好な、高性能、 広帯域な表面波共振子フィルタを提供する。

【構成】36°YカットX伝搬のLiTaOa基板1上に、IDT2,3が近接して形成され、IDT2,3の外側には反射器4、4が形成され、IDT2,3及び反射器4、4を覆うようにSiO2膜5が形成されている。IDT2,3及び反射器4、4はAlまたはAlの合金からなり、IDT2,3及び反射器4、4の電極膜厚、SiO2膜5の膜厚及びIDT2,3の総電極指対数が特定の範囲に限定されて形成されている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 36° YカットX伝搬のLiTaO₃ 基 板上に、複数のIDTが近接して形成され、前記複数の IDTの両側に反射器が形成され、

前記IDTの電極及び前記反射器の電極がAlまたはA 1を主成分とする合金からなり、前記 I D T 及び前記反 射器を覆うようにSiO2 膜が形成され、

前記IDT及び前記反射器の電極膜厚をT、前記SiO 2 膜の膜厚をH、表面波の波長をλとしたとき、電極膜 厚比T/λ及びS i O2 膜厚比H/λが、

2.  $6\% \le T/\lambda \le 4$ . 8%

 $22\% \le H/\lambda \le 38\%$ 

に設定されていることを特徴とする表面波共振子フィル

【請求項2】 請求項1に記載のIDT及び反射器から なる構成を1段として、36° YカットX伝搬のLiT aO3 基板上に、前記構成が複数段形成され、前記各段 が縦続接続されていることを特徴とする表面波共振子フ ィルタ。

【請求項3】 前記SiO2 膜がRFマグネトロンスパ 20 ッタ法により形成されたことを特徴とする請求項1また は請求項2に記載の表面波共振子フィルタ。

【請求項4】 請求項1に記載のIDTの総電極指対数 Ntが、

#### $1.4 \le N.t \le 6.8$

に設定されていることを特徴とする請求項1~請求項3 のいずれかに記載の表面波共振子フィルタ。

【請求項5】 SiO₂ 膜厚比H/λが

 $26\% \le H/\lambda \le 36\%$ 

のいずれかに記載の表面波共振子フィルタ。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、圧電基板上に複数のⅠ DTと反射器とを形成してなる表面波共振子フィルタに 関する。

### [0002]

【従来の技術】近年、各種通信機器に表面波フィルタが 使用されるようになり、特に中間周波数 (IF) 段にお いてはデジタル化での移行に伴い、小形、高選択度、広 40 帯域で群遅延特性のよいフィルタが要求されている。従 来より、小形、低損失、広帯域な表面波フィルタとし て、36°YカットX伝搬のLiTaO。基板上に、複 数のIDT(インターデジタルトランスデューサ)を近 接配置し、IDTの両側に反射器を形成した縦結合型の 表面波共振子フィルタが広く知られている。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 36° YカットX伝搬LiTaO3 基板を用いた共振子

℃であり、例えば常温±50℃の温度範囲で、周波数が ±1750ppmも変化する。このため、フィルタとし ての実使用上の実効的な通過帯域幅が狭くなり、通過帯 域近傍の選択度(隣接チャンネルでの減衰量)が不足す るという問題があった。また、反射係数の大きさの関係 で、充分にエネルギーを閉じ込めるために多くの本数の 反射電極指からなる反射器が必要となり、小形化が困難 であるという問題があった。

【0004】そこで、本願発明者は、量産性に優れたR 10 Fマグネトロンスパッタ法により1DT及び反射器上に S i O₂ 膜を形成して、周波数温度特性を改善する検討 を行い、A1電極の膜厚、SiOzの膜厚などを、特定 の範囲に限定することにより、周波数温度特性を改善す るとともに、反射器の電極指の本数を低減してより小形 化できることを見出だした。

【0005】本発明の目的は、IDT及び反射器の電極 膜厚、SiO₂ 膜厚、IDTの電極指対数を特定の範囲 に限定することにより、安価かつ小形で、温度特性の良 好な、高性能、広帯域な表面波共振子フィルタを提供す ることにある。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、請求項1に係る表面波共振子フィルタは、36°Y カットX伝搬のLiTaO₃ 基板上に、複数のIDTが 近接して形成され、前記複数のIDTの両側に反射器が 形成され、前記IDTの電極及び前記反射器の電極がA l またはAlを主成分とする合金からなり、前記IDT 及び前記反射器を覆うようにSiO2膜が形成され、前 記IDT及び前記反射器の電極膜厚をT、前記SiO2 に設定されていることを特徴とする請求項 $1\sim$ 請求項4 30 膜の膜厚をH、表面波の波長を $\lambda$ としたとき、電極膜厚 比T/λ及びSiO₂ 膜厚比H/λが、

2.  $6\% \le T/\lambda \le 4$ . 8%

 $22\% \le H/\lambda \le 38\%$ 

に設定されていることを特徴とするものである。

【0007】請求項2に係る表面波共振子フィルタは、 請求項1に記載のIDT及び反射器からなる構成を1段 として、36°YカットX伝搬のLiTaO₃基板上 に、前記構成が複数段形成され、前記各段が縦続接続さ れていることを特徴とするものである。

【0008】請求項3に係る発明は、請求項1または請 求項2に記載の表面波共振子フィルタにおいて、前記S iO₂ 膜がRFマグネトロンスパッタ法により形成され たことを特徴とするものである。

【0009】請求項4に係る発明は、請求項1~請求項 3のいずれかに記載の表面波共振子フィルタにおいて、 1段のIDTの総電極指対数Ntが、

 $1.4 \le N.t \le 6.8$ 

に設定されていることを特徴とするものである。

【0010】請求項5に係る発明は、請求項1~請求項 フィルタでは、中心周波数温度係数が約-35ppm/ 50 4のいずれかに記載の表面波共振子フィルタにおいて、

S i O₂ 膜厚比H/λが  $26\% \le H/\lambda \le 36\%$ 

に設定されていることを特徴とするものである。

#### [0011]

【作用】請求項1に係る発明によれば、電極膜厚比T/ λ及びS i O₂ 膜厚比H/λを特定の範囲に限定するこ とで、後述するように、小形で、挿入損失の小さな、温 度特性の良好な表面波共振子フィルタを得ることができ

ることにより、より高選択度のフィルタ特性を得ること ができる。

【0013】請求項3に係る発明によれば、RFマグネ トロンスパッタ法によりSiOz膜を成膜することで、 量産性を向上することができる。

【0014】請求項4に係る発明によれば、IDTの電 極指対数を特定の範囲に限定することで、必要帯域幅を 確保し、かつ通過帯域内でのリップルを低減することが できる。

【0015】請求項5に係る発明によれば、SiO2膜 20 厚比H/λをさらに限定することで、周波数温度特性を さらに改善することができる。

#### [0016]

【実施例】以下、本発明をその実施例を示す図面に基づ いて説明する。以下の平面図において、点塗り潰し部は SiO₂膜で覆われた部分を示す。

【0017】本発明の第1実施例に係る表面波共振子フ イルタの構成を図1(a)及び(b)に示す。図1

(a) は本発明の表面波共振子フィルタの最小単位であ る基本構成を示す平面図であり、(b)は(a)のX- 30 X線断面図である。

【0018】図1に示すように、本実施例の表面波共振 子フィルタは、36°YカットX伝搬LiTaOa基板 1上に、互いの電極指が間挿し合うように配置された― 対のくし型電極2a、2b及び一対のくし型電極3a、 3bからなるIDT2及びIDT3が近接して形成さ れ、IDT2、3の外側には複数の反射電極指からなる 反射器4、4が形成されている。そして、IDT2、3 及び反射器4、4を覆うように、36°YカットX伝搬 LiTaO<sub>3</sub> 基板1上にSiO<sub>2</sub> 膜5が形成されてい る。

【0019】各くし型電極2a, 2b, 3a, 3bには 接続部に信号入出力のための露出電極部2c,2d,3 c, 3 d が設けられ、露出電極部 2 c, 3 c は入出力端 子6、6に接続され、露出電極部2d,3dはアースに 接続される。

【0020】具体的には、36° YカットX伝搬LiT aOs 基板1上にAl、またはAlにCuを1wt%程 度添加したAI合金を蒸着またはスパッタ等により成膜

IDT2、3及び反射器4、4が形成される。次ぎに、 IDT2, 3及び反射器4、4を覆うように、RFマグ ネトロンスパッタ等によりSiO₂ 膜5が形成される。 【0021】露出電極部2c, 2d, 3c, 3dは、例 えば、CF』プラズマの中でイオンエッチングによりS i O₂ 膜5の一部を除去するか、あるいは、S i O₂ 膜 5形成時にマスクを用いることにより、電極を露出させ て形成される。

【0022】なお、上記表面波共振子フィルタは、36 【0012】請求項2に係る発明によれば、多段接続す 10 ° YカットX伝搬LiTaO3 の母基板 (ウエハ) に多 数形成され、ダイサー等により個々に切断、分割されて 製造される。図1(b)において、TはIDT2、3及 び反射器4、4の電極膜厚、HはSiΟ₂ 膜の膜厚、λ は表面波の波長である。

【0023】本発明の第2実施例に係る表面波共振子フ イルタの構成を図2に示す。図2は表面波共振子フィル タの平面図であり、図1に示す構成を複数形成したもの である。図2に示すように、本実施例の表面波共振子フ イルタは、36° YカットX伝搬LiTaO。基板1上 に、図1に示すIDT2、3及び反射器4、4で構成さ れる表面波共振子フィルタが3つ並列に配置され、各表 面波共振子フィルタを縦続接続して構成されている。 I DT及び反射器の構成は図1に示すものとほぼ同様の構 成であり、その説明を省略する。

【0024】このように、IDT及び反射器で構成され る縦結合型の表面波共振子を多段接続することにより、 帯域外減衰量の大きな高選択度の表面波共振子フィルタ を得ることができる。

【0025】以下、図1に示す構成において、電極膜 厚、S·i O<sub>2</sub> 膜厚、電極指間ピッチ、電極指対数等を変 化させて多数の試料を作成した実験の結果に基づいて、 本発明に係る表面波共振子フィルタの設計条件の設定理 由を説明する。

【0026】図3は、電極膜厚比T/えをパラメータと して、SiO2 膜厚比H/1に対するIDTまたは反射 器の電極指1本あたりの反射係数の変化を示した図であ る。図3に示すように、電極指1本あたりの反射係数 は、SiO2 膜厚H及び電極膜厚Tに依存し、いずれも 膜厚が厚くなるにつれて単調増加する。

【0027】従来の(SiO₂膜を形成しない)36° YカットX伝搬LiTaO3 基板においては、共振子フ ィルタ内に充分に表面波のエネルギーを閉じ込め、所望 の特性(挿入損失)を得るために、例えば電極膜厚比T /んを4.5%とした場合、反射器の電極指の本数が約 50本必要であった。この場合( $T \diagup \lambda = 4$ . 5%、H/λ=0)の電極指1本の反射係数は、図3に示すよう に0.06となる。

【0028】表面波共振子フィルタの小形化を図るため には、反射器の電極指の本数を減少することが必須であ した後、フォトリソグラフィ等によりパターニングして 50 り、反射器の電極指の本数を従来の50本以下とするに

は、電極指1本の反射係数は少なくとも0.06以上が 必要となる。しかしながら、SiO₂ 膜厚が厚いと、成 膜時間が長くなり生産性が低下するうえに、基板に応力 が生じ組立て加工中や組立て後に基板が割れたり、電極 膜やSiO₂ 膜にクラックが生じるという現象が起こ

【0029】実用性のあるSiO2 膜厚比H/んである 0~40%の範囲において、電極指1本の反射係数を 0. 06以上とするには、図3から、電極膜厚比T/λ が2.6%以上あればよいことがわかる。したがって、 電極膜厚比T/λを2.6%以上に設定することが、小 形化を図るため条件となる。

【0030】図4は、SiO2 膜厚比H/λを29.5 %とし、電極膜厚比T/λとフィルタの最小挿入損失の 関係を示した図である。

【0031】図4に示すように、電極膜厚比T/λが 2.5%付近までは、電極膜厚比 $T/\lambda$ が厚くなるにつ れ、反射器によって表面波のエネルギーが共振子フィル 夕内に閉じ込められるため、挿入損失が小さくなってい く。しかし、電極膜厚比T/んが2.5%付近を越える 20 と、電極膜厚比T/λを厚くすることにより挿入損失が 大きくなっていく。これは、電極における表面波からバ ルク波へのモード変換による損失が大きくなってくるた めと考えられる。

【0032】一般的に、IF段に用いられるフィルタに おいては高選択度が要求されるため、図2に示すような 多段縦続接続構成のフィルタが必要となる。 したがっ て、図2に示すような3段縦続接続を行うと、1段の構 成のものに比べ、挿入損失は約3倍となる。つまり、図 4における挿入損失の3倍が実際に使用されるフィルタ 30 の最小挿入損失となる。

【0033】一方、広帯域フィルタによく用いられるト ランスバーサル型の設計手法では最小挿入損失は双方向 性損6 d Bに他の損失を加えた値となるため、より低損 失化をめざした本発明においては、3段縦続接続にした 場合の最小挿入損失を6 d B以下を目標とした。つま り、図4においては、挿入損失2dBの領域であり、電 極膜厚比T/んを4.8%以下に設定すればよいことが わかる。

【0034】図5は、電極膜厚比T/λをパラメータと 40 して、SiΟ₂ 膜厚比H/λと周波数温度係数の関係を 示した図である。

【0035】図5に示すように、周波数温度係数はSi O2 膜厚比H/λに依存するが、電極膜厚比T/λにも 依存し、零温度係数の得られるSiO2膜厚比H/λ\*

①電極膜厚比T/λを

②S i O2 膜厚比H/λを 望ましくは

以上の結果に基づいて作成した公称中心周波数が11

\*は、電極膜厚比T/λにより変化する。

【0036】周波数温度係数の設計目標を従来のものの 1/3以下として±10ppm/℃以内とした。図5か ら、周波数温度係数を±10ppm╱℃以内にするに は、前述した電極膜厚比T/2の設計条件2.6%~ 8%において、SiO₂膜厚比H/λを22%~3 8%に設定すればよいことがわかる。

【0037】また、周波数温度係数を水晶基板を用いた 表面波フィルタの周波数温度係数に匹敵する±5ppm /℃以内とするには、SiO₂ 膜厚比H/λを26%~ 10 36%に設定すればよいことがわかる。

【0038】次ぎに、帯域内リップルを抑え、必要通過 帯域幅を得るためのIDTの電極指の対数の適正な設定 条件について述べる。図1に示したIDT2、3のそれ ぞれの電極指対数をN、これら2つのIDTの電極指対 数の総和(総電極指対数)をN t とした場合、総電極指 対数Ntを変化させたときの帯域内リップル及び総電3 d B比帯域幅の変化を図6に示す。

【0039】例えば、ヨーロッパのデジタルコードレス 電話(DECT)の中心周波数110.6MHェのIF フィルタでは、必要通過帯域幅は公称中心周波数±0. 6MHz以上、幅1.2MHz以上必要である。従来の 36° YカットX伝搬LiTaO3 基板を用いた表面波 共振子フィルタでは、温度特性、経時変化を含めて1. 5MHz以上の通過帯域幅が必要であったが、本発明に よれば、周波数温度係数を非常に小さくできるので、温 度特性及び経時変化を考慮しても通過帯域幅を1.3M Hz、比帯域幅にして約1.2%あれば実用上問題がな い。また、帯域内リップルは、実用上1dB以下である ことが要求される。

【0040】図6より、3dB比帯域幅1.2%以上、 帯域内リップル1dB以下とするには、総電極指対数N t を 1 4 ~ 6 8 に、電極指対数 N を 7 ~ 3 4 に設定すれ ばよいことがわかる。なお、IDTの電極指対数が多く なれば、挿入損失が大きくなってくるが、総電極指対数 Ntの上限値である68で、挿入損失が2dB以下であ ることは確認している。

【0041】以上説明したように、36° YカットX伝 搬LiTaO。基板を用いて、SiO2 膜を形成するこ とで、周波数温度係数が±10ppm/℃以内で、かつ 小形化が可能で、低損失、低リップルの表面波共振子フ ィルタを実現するには、非常に限定された設計条件が必 要である。その設計条件をまとめると以下のようにな る。

[0042]

2.  $6\% \le T/\lambda \le 4$ . 8% $22\% \le H/\lambda \le 38\%$ 

 $26\% \le H/\lambda \le 36\%$ 

50 0.6MHzの表面波共振子フィルタの特性の一例を図

③IDTの総電極指対数Ntを 14≦Nt≤68

7に示す。図7は、図2に示す3段構成において、IDT及び反射器をA1電極で形成し、RFマグネトロンスパッタによりSiO2 膜を成膜し、電極膜厚比T $/\lambda$ を3.7%、SiO2 膜厚比H $/\lambda$ を29.5%、総電極指対数Ntを28に設定した表面波共振子フィルタの周波数特性である。

【0043】3dB帯域幅は約1.5MHzであり、比帯域幅で1.36%が得られた。また、周波数温度係数を非常に小さく形成することができ、大きな減衰量が要求される $110.6MHz\pm1.728MHz$ の周波数 10で、常温 $\pm50$ ℃の温度範囲にて46dB以上の減衰量を確保することができた。また、反射係数を測定したところ、電極指1本あたりの反射係数は約0.75であった。

【0044】従来の $SiO_2$  膜を形成しないフィルタと上記実施例のフィルタの中心周波数温度変化を図8に示す。図8から、中心周波数の温度変化が-35ppm/ $\mathbb{C}$ から $+0.6ppm/\mathbb{C}$ に大幅に改善されていることがわかる。

【0045】また、電極指1本あたりの反射係数が約0.75と大きくとれ、反射器の電極指の本数を50本から40本に減らすことができ、また、IDTの放射コンダクタンスが大きくなるので、IDTの電極指対数を少なくでき、チップサイズとしては面積比で2/3に小形化することができ、表面波フィルタ用パッケージとして入手できるもののなかで従来比約1/3のサイズのパッケージに収納することができた。

【0046】なお、上記実施例では反射器間に2つのIDTを形成し、縦0次モードと縦1次モードを利用した2重モード共振子フィルタで説明したが、反射器間に330つ以上のIDTを形成した表面波共振子フィルタにも本発明を適用できる。

#### [0047]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、36°YカットX伝搬LiTaO。基板上に形成されたIDT及び反射器を覆うようにSiO2膜が形成され、かつ、電極膜厚比、SiO2膜厚比及び総電極指対数を

特定の範囲に設定することにより、小形で、温度特性の 良好な、高性能、広帯域な表面波共振子フィルタを得る ことができる。

【0048】また、量産性のよいRFマグネトロンスパッタによりSiO2膜を成膜することで、SiO2の成膜コストを低減し、チップサイズの小形化により1枚のウエハーでの取れ個数が約1.5倍となり、温度特性の改善により歩留まりを向上することもでき、材料コストを低減するとともに、生産性を向上することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】 (a) は本発明の第1実施例に係る表面波共振 子フィルタの平面図、 (b).は (a) のX-X線断面図 である。

【図2】本発明の第2実施例に係る表面波共振子フィル タの平面図である。

【図3】本発明の実験により得られた、電極膜厚比 $T/\lambda$ をパラメータとして、 $SiO_2$  膜厚比 $H/\lambda$ と電極指1本の反射係数の関係を示す図である。

【図4】本発明の実験により得られた、電極膜厚比T/ 20 礼と挿入損失の関係を示す図である。

【図5】本発明の実験により得られた、電極膜厚比 $T/\lambda$ をパラメータとして、 $SiO_2$  膜厚比 $H/\lambda$ と周波数温度係数の関係を示す図である。

【図6】本発明の実験により得られた、IDTの電極指総対数Ntとリップル及び3dB比帯域幅の関係を示す図である。

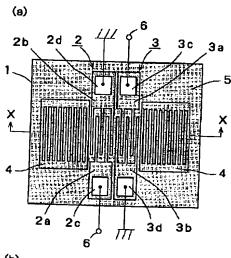
【図7】本発明に係る表面波共振子フィルタのフィルタ 特性の一例である。

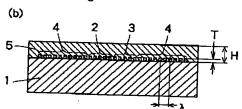
【図8】本発明に係る表面波共振子フィルタと従来の表 の面波共振子フィルタの中心周波数の温度変化を示す図で ある。

### 【符号の説明】

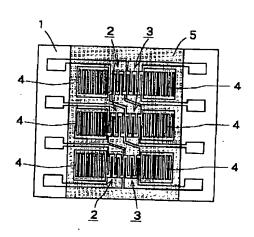
- 36°YカットX伝搬LiTaO3 基板
- 2, 3 IDT
- 4 反射器
- 5 SiO₂膜

【図1】

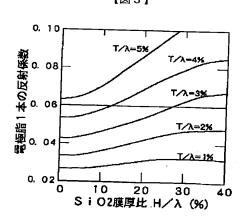




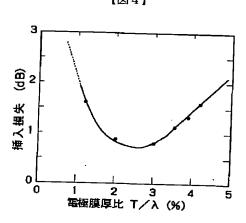
[図2]

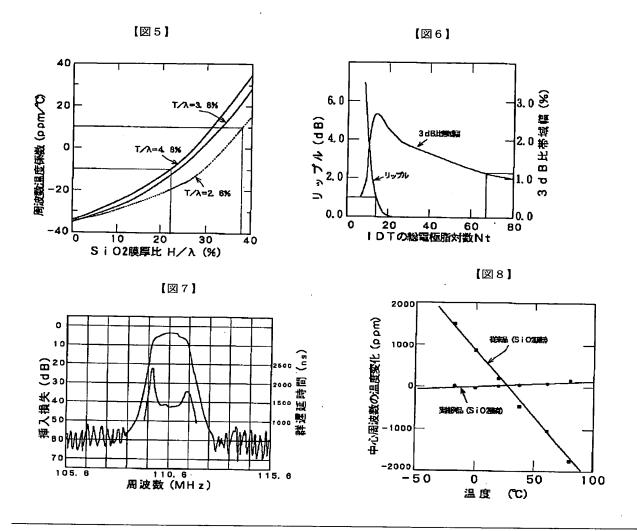


【図3】



【図4】





【手続補正書】

【提出日】平成8年3月19日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 3

【補正方法】変更

【補正内容】

【0043】3dB帯域幅は約1.5MHzであり、比帯域幅で1.36%が得られた。また、周波数温度係数を非常に小さく形成することができ、大きな減衰量が要求される $110.6MHz\pm1.728MHz$ の周波数で、常温 $\pm50\%$ の温度範囲にて46dB以上の減衰量を確保することができた。また、反射係数を測定したところ、電極指1本あたりの反射係数は約0.075であった。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 4 5

【補正方法】変更

【補正内容】

【0045】また、電極指1本あたりの反射係数が約0.075と大きくとれ、反射器の電極指の本数を50本から40本に減らすことができ、また、IDTの放射コンダクタンスが大きくなるので、IDTの電極指対数を少なくでき、チップサイズとしては面積比で2/3に小形化することができ、表面波フィルタ用パッケージとして入手できるもののなかで従来比約1/3のサイズのパッケージに収納することができた。